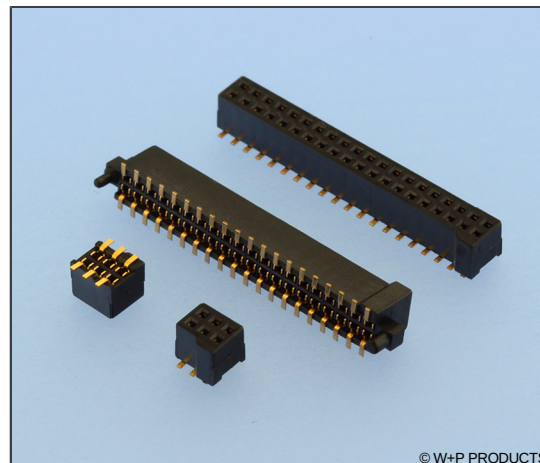


SMT-Buchsenleisten RM 1,27mm, stehend, 2-reihig – BH 3,6/4,5mm, durchsteckbar

SMT Female Headers, 1.27mm Pitch, Vertical, Double Row – 3.6/4.5mm Profile, Pass Through

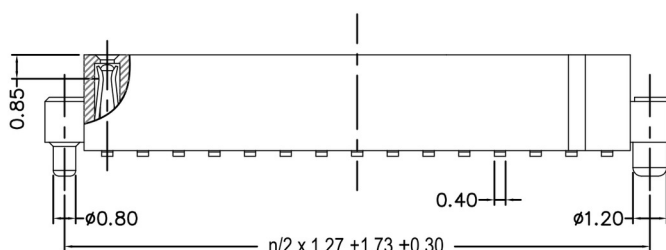
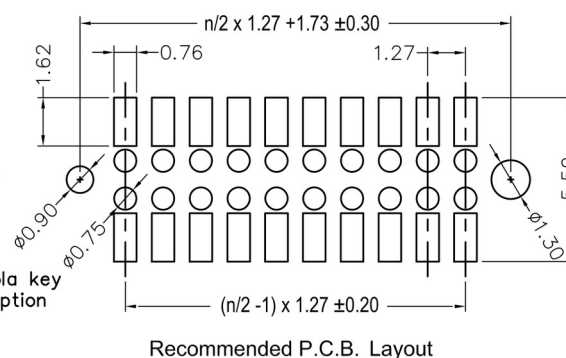
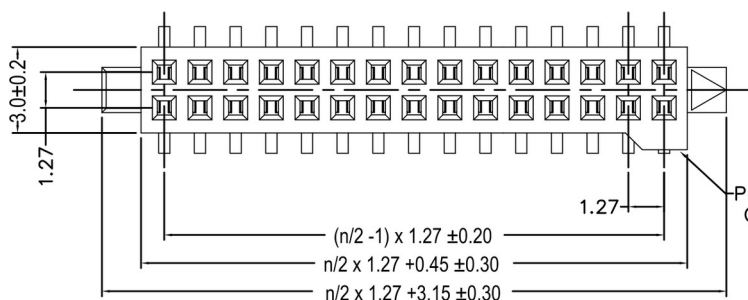
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to plating options, over Ni
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	keine
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	none
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
Insulation Resistance	> 1 GΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	500 V AC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	Kurzes Reflow-Lötverfahren
Processing	Fast reflow soldering

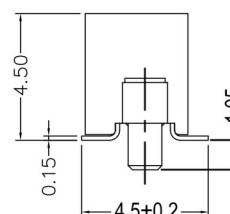


© W+P PRODUCTS

Passende Wannensteinleisten:
Compatible Box Headers:
6110, 6111



Profile -46-



Series	Contacts*	Profile*	Plating	Locating Pegs*	Polarisation Key*	Packaging*
6067	030	36	00	10	10	TR
	006-100 Zweireihig Double row	46 Bauhöhe 4,5mm 4.5mm profile	00 Vergoldet Gold plated	00 Ohne Loc. pegs W/o loc. pegs 10 Mit Loc. pegs With loc. pegs	00 Ohne Pola.key W/o pola.key 10 Mit Pola.key With pola.key	TR PPTR

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

TR Tape & Reel ohne P&P-Pads / Tape & Reel w/o P&P-Pads
PPTR Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

Informationen zum kurzen Reflow-Lötverfahren

Fast Profile Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Temperatur Lötbereich T_L	230°C
Verweildauer oberhalb T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1,5°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C max.
Dauer Höchsttemperatur	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 4,5min

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Soldering Range Temperature T_L	230°C
Duration above T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1.5°C / s
Peak Temperature T_P	260°C max.
Duration Peak Temperature	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 4.5min

